

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元至 17,500 万元，同比增长 36.28%至 58.99%。
- 扣除非经常性损益事项后，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 13,500 万元至 15,500 万元，同比增长 49.54%至 71.69%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

（二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元至 17,500 万元，与 2024 年上半年同比增长 36.28%至 58.99%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 13,500 万元至 15,500 万元，与 2024 年上半年同比增长 49.54%至 71.69%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润：11,006.91万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：9,027.95万元。

（二）每股收益：0.17 元。

三、本期业绩预增的主要原因

随着汽车智能化的快速发展，车规CIS芯片市场需求显著增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与技术领先优势持续提升；同时公司持续加大先进封装技术的创新开发，不断满足客户新业务与新产品的技术需求；不断优化生产工艺与管理模式，提升生产运营与管理效率。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年7月12日